

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】令和1年5月16日(2019.5.16)

【公開番号】特開2018-101540(P2018-101540A)

【公開日】平成30年6月28日(2018.6.28)

【年通号数】公開・登録公報2018-024

【出願番号】特願2016-246915(P2016-246915)

【国際特許分類】

H 01 R 13/52 (2006.01)

H 01 R 13/405 (2006.01)

【F I】

H 01 R 13/52 301 F

H 01 R 13/405

【手続補正書】

【提出日】平成31年4月3日(2019.4.3)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0024

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0024】

図4に示すように、プレート32には、隔壁31b側に凹部32dが形成されている。本実施形態において、プレート32には、4つの凹部32dが形成されている。図4に示すように、隔壁31bには、プレート32の凹部32dと連通する貫通孔31Xが形成されている。図3及び図4に示すように、貫通孔31Xは、コネクタ22に配列された複数の端子33を避けるように形成されている。なお、図4に示すプレート32の凹部32dは、隔壁31bの貫通孔31Xと連通して形成される。つまり、プレート32には4つの凹部32dが形成されている。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0025

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0025】

これらの凹部32dは、ハウジング31を形成する工程において、プレート32の位置決めに用いられる。

図6に示すように、金型50は、上述のハウジング31(図4参照)の形成に用いられる。この金型50には、ピン状の位置決め部材51が立設されている。この位置決め部材51は、プレート32の凹部32dに挿入される。この位置決め部材51の挿入により、プレート32が金型50の内面50aから離間した状態で、プレート32が固定される。このプレート32と金型50の内面50aとの隙間に、図2に示すハウジング31の隔壁31bが形成される。そして、ハウジング31を形成するために溶融された樹脂が金型50内に圧入される。このとき、プレート32の凹部32dに位置決め部材51が挿入されているため、この樹脂が圧入されたとき、中子つまりプレート32及び端子33は移動しない。そして、樹脂の硬化によりハウジング31が形成される。このため、ハウジング31の隔壁31bに、位置決め部材51に応じた貫通孔31Xが形成される。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0027

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0027】

コネクタ22の複数の端子33は、プレート32に対して圧入される。プレート32に対する複数の端子33の圧入は、複数の端子33を配列した状態で、自動機により行うことができる。このため、圧入のための時間は僅かである。このプレート32及び複数の端子33を中子としたインサート成形によりハウジング31が形成される。このため、複数の端子33を1本ずつ金型50に配設するインサート成形に比べ、僅かな時間で複数の端子33を金型50に配設することができる。このため、コネクタ22の形成に要する時間が短縮され、コネクタ22のコストが低減される。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0030

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0030】

(2) コネクタ22の複数の端子33は、プレート32に対して圧入される。プレート32に対する複数の端子33の圧入は、複数の端子33を配列した状態で、自動機により行うことができる。このため、圧入のための時間は僅かである。このプレート32及び複数の端子33を中子としたインサート成形によりハウジング31が形成される。このため、複数の端子33を1本ずつ金型50に配設するインサート成形に比べ、成型における手間が少なくなり、僅かな時間で複数の端子33を金型50に配設することができる。このため、成型における手間とコネクタ22の形成に要する時間を短縮することができ、コネクタ22のコストを低減することができる。